



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、Embedded World 2018 において 産業用 IoT エッジコンピューティングシステムの導入を加速する 最新ソリューションを披露

信頼性とスケーラビリティを備えたソリューションにより、もっとも要求の厳しい工場環境に
豊富な I/O とネットワーク接続のカスタマイズオプションを提供

2018年2月14日 台湾・新北市 - VIA Technologies, Inc.は、2月27日から3月1日まで、ドイツ・ニュルンベルグで開催される Embedded World 2018 において、産業 IoT および企業向け IoT アプリケーション向けに成長するエッジコンピューティングの最新ソリューションを展示いたします。VIA ブースは、ニュルンベルグ・エキシビション・センターのホール 2 #2-551 です。

VIA エッジコンピューティングシステムは、工場内の機器や建物の設備からミッションクリティカルなデータをリアルタイムで効率的に収集・分析し、企業内ネットワークやクラウドに接続されたサーバーや、その他のデバイスに安全に接続できるようにすることで、産業オートメーションプロセスの最適化を容易にします。



Hall 2, Booth #551 Exhibition Centre
Nuremberg, Germany

February 27-March 1, 2018

VIA Technologies, Inc の国際マーケティング担当 VP、リチャード・ブラウンは、「堅牢なファンレス設計と豊富な I/O およびネットワーク接続オプションを組み合わせた VIA エッジコンピューティングシステムは、もっとも要求の厳しい生産環境でも動作すべく、すぐれた信頼性と柔軟性を提供します」と述べています。

Press Release

VIA、Embedded World 2018 において産業用 IoT エッジコンピューティングシステムの導入を加速する最新ソリューションを披露

2/3

「産業機器、設備、プロセスの管理と監視を容易にすることで、本システムは工場全体の生産性を向上させ、運用コストを削減することにも役立ちます」

VIA ARTiGO A630 オートメーションテレメトリーシステム

とてもスリムでファンレスの VIA ARTiGO A630 オートメーションテレメトリーシステムは、RS-232 ポート、オプションの 3G または Wi-Fi モジュールを含む豊富な I/O 機能セット接続性を提供することにより、CNC 機械およびその他の産業機器のリモート管理および監視を最適化します。また、特定の要件を満たすべく、複数のカスタマイズオプションも用意されています。

VIA VB9001 ファイアウォールセキュリティプラットフォーム

5Gbit イーサネットポートと広範な I/O およびワイヤレス接続オプションを備えた高度に統合された 3.5 インチ SBC の VIA VB9001 は、クラウドに接続している間に潜在的なオンライン攻撃から CNC、PLC、およびその他の産業機器を堅牢に守る。信頼性にすぐれた高性能なエッジゲートウェイソリューションです。VIA VB9001 ファイアウォールセキュリティプラットフォームは、低消費電力、ファンレス動作、豊富なカスタマイズオプションにより、幅広い産業用ネットワークセキュリティ、分散制御システム (DCS)、および監視アプリケーションに対応する汎用ソリューションです。

VIA ARTiGO A600 スマートビルディングオートメーションシステム

3.75kV の完全絶縁を備えた 4 つの 3 極 Phoenix RS-485 ポートを含む豊富な I/O 機能を備えたこの超小型ファンレスシステムによって、工場の暖房、換気、空調、照明などさまざまな機器にシームレスに接続できるようになり、エネルギー消費を最小限に抑えつつ、安全性を高めることができます。内蔵イーサネットポートとオプションの Wi-Fi モジュールは、信頼性にすぐれた機器とクラウド間通信を保証し、遠隔オンライン監視および管理アプリケーションを容易にし、運用および保守コストを最小限に抑えます。

VIA は Embedded World 2018 において、産業 IoT エッジコンピューティングシステムに加え、スマートビルディング、スマート販売、スマートエンタープライズ IoT など、幅広いソリューションを披露します。その詳細については、<http://www.viatech.com/ja/about/events-2018/embedded-world-2018/> をご参照ください。

本リリースに関連する画像については、<https://www.viagallery.com/via-embedded-world-2018/> をご覧ください。

VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc. は、高度に統合された組み込み用プラットフォームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

VIA、Embedded World 2018 において産業用 IoT エッジコンピューティングシステムの導入を加速する最新ソリューションを披露

3/3

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。